BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

AUSLEGESCHRIFT 1165962

Internat. Kl.: C 23 b

Deutsche Kl.: 48 a - 5/20

Nummer:

1165962

Aktenzeichen:

R 21343 VIb/48a

Anmeldetag:

14. Juni 1957

Auslegetag:

19. März 1964

Gegenstand der Hauptpatentanmeldung sind saure Bäder zur Herstellung von einebnenden Kupferüberzügen unter Verwendung von Vorkondensaten von Thioharnstoff mit Formaldehyd zusammen mit Grundglänzern.

Es wurde gefunden, daß die Eigenschaften solcher sauren Bäder weitgehend verbessert werden können, wenn zur Vorkondensation zusammen mit Thioharnstoff ein anderer, mindestens zwei NH2-Gruppen enthaltender Stoff verwendet wird. Solche Verbindungen 10 müssen ebenso wie Thioharnstoff mindestens zwei H₂N-Gruppen aufweisen, um veine Brücke« zwischen zwei Formaldehydmolekülen zu bilden.

So entstehen Ketten bzw. zwei- oder dreidimensional vernetzte Gebilde, die im einfachen Fall etwa folgende 15 Struktur annehmen können:

$$\begin{pmatrix} S \\ \cdot \parallel \\ -CH_2 - NH - C - NH - CH_2 - NH - R - NH - CH_2 - \end{pmatrix}_{n_{20}}$$

wo - R - einen Benzol-, Naphthalin-, Diphenyl-, Anthracen-, Phenanthren-, Pyren-, Triazin- oder einen anderen heteroxyklischen aliphatischen oder einen cycloaliphatischen Rest bedeutet. Die Kondensation zwischen Thioharnstoff und der mindestens zwei H₂N-Gruppen enthaltenden Verbindung, z. B. Melamin, liegt optimal bei 1:1; doch können auch andere Verhältnisse gewählt werden, z. B. 1:2. Damit wird geschwächt und seine Inhibition für den beschriebenen Zweck günstig abgestimmt.

Statt Melamin können auch andere, mindestens zwei H₂N-Gruppen enthaltende Substanzen gewählt amin, Diamino-diphenylharnstoff, Diamino-stilben, Harnstoff, o-Dianisidin, o-Tolidin, Phenylendiamine, 2,4'-Diamino-diphenyl, Parafuchsin, Kongorot, Benzidin, Guanidin, Benzidin-2,2'-disulfonsäure, Diaminostilben-disulfonsäure, 1,5-Naphthylendiamin-3,7-disul- 40 fonsäure, Naphthylendiamine.

In Mischkondensationsprodukten, z. B. im Thioharnstoff-Formaldehyd-Naphthylendiamin-Kondensat, ist die »Aktivität« des Thioharnstoffes durch die Anwesenheit von wenig aktiven Gruppen weitgehend 45 abgeschwächt. Außerdem entstehen beim teilweisen Ersatz der Thioharnstoffmoleküle durch Naphthylendiaminmoleküle größere Kondensationsmoleküle, die sich für die Einebnung und deren Konstanz auch bei höheren Temperaturen besonders eignen.

Neben einer Steigerung der Einebnung durch diese Kondensationsprodukte wird außerdem eine Aus-

Saure Bäder zur Herstellung von einebnenden Kupferüberzügen

Zusatz zur Anmeldung: R 20796 VI b / 48 a --Auslegeschrift 1 152 863

Anmelder:

Riedel & Co., Bielefeld, Wiesenstr. 23

Als Erfinder benannt: Dipl.-Chem. Gregor Michael, Bielefeld, Dipl.-Chem. Dr. Emil Roth. Brackwede bei Bielefeld

2

breitung der Einebnung auch im Bereich niedriger Stromdichten, eine bessere Toleranz gegenüber den Konzentrationsveränderungen des Einebners im Bade tritt bei etwa 110 bis 130°C ein. Das Molverhältnis 25 und eine Erhöhung der Temperaturgrenzen für die Einebnung und den Glanz erzielt.

Es ist bekannt, daß das Kupfer, insbesondere bei hohen Temperaturen, sich sehr schlecht inhibieren läßt. Nach der Erfindung kann die Inhibition durch die aggressive Wirkung des Thioharnstoffes ab- 30 entsprechend große Inhibitormoleküle mit bestimmtem Kondensationsgrad unter Beibehaltung seiner vaktiven a Eigenschaften, bedingt durch = N - C = S-Gruppen, verstärkt werden. Die so aufgebauten sauren Kupferbäder liefern noch bei 35 bis 40°C glänzende, auswerden, z. B. Diamino-azobenzol, Diamino-diphenyl- 35 gezeichnete einebnende Kupferüberzüge, dagegen arbeiten die gleichen Bäder auf Formaldehyd-Thioharnstoff-Basis nur bis 25°C.

Beispiele

- 1. In dem Bad folgender Zusammensetzung:
 - g/l CuSO₄ · 4 H₂O,
 - 60 g/l konzentrierte H₂SO₄,
 - g/l Alkylpolyglykolnetzer,
 - 0,1 g/l Diäthyldithiocarbaminbuttersäure,
 - 0,1 g/l HCl,
- 0,03 g/l Thioharnstoff-Formaldehyd-Diaminodiphenylharnstoff-Kondensat,

erhält man bei Stromdichten von 1 bis 6 A/dm² und 15 bis 35°C auf 26 μ starken Kupferschichten Glanz 50 und eine gute Einebnung, die die Schleifriefen des O-Schliffes vollkommen zum Verschwinden bringt.

2. Das Bad folgender Zusammensetzung:

g/l CuSO₄ · 5 H₂O, g/l konzentrierte H₂SO₄, 200

g/l Alkylpolyglykolnetzer,

0,4 g/l Pyrazin-3,5-Dithioglykolsäure, 0,04 g/l Thioharnstoff-Formaldehyd-Diamino- 5 diphenylamin-Kondensat,

zeigt bei Stromdichten von 1 bis 6 A/dm² im Temperaturintervall 15 bis 40°C glänzende, gut einebnende Kupferüberzüge.

Patentanspruch:

Saure Bäder zur Herstellung von einebnenden Saure Bäder zur Herstellung von einebnenden Kupferüberzügen unter Verwendung von Grundglänzern und einem Vorkondensationsprodukt aus Thioharnstoff und Formaldehyd nach Patentanmeldung R 20796 VI/48a, dadurch gekennzeichnet, daß sie ein Vorkondensationsprodukt aus Thioharnstoff, Formaldehyd und einer Verbindung mit mindestens zwei NH2-Gruppen enthalten.